

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2026-021

# 无锡帝科电子材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	帝科股份	股票代码	300842
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭民	秦超	
办公地址	江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号	江苏省无锡市宜兴市屺亭街道永盛路 8 号	
传真	0510-87129111	0510-87129111	
电话	0510-87825727	0510-87825727	
电子信箱	ir@dkem.cn	ir@dkem.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司主要业务及产品

公司以“全球能源结构转型与国家半导体战略”为长期可持续发展契机与战略依托，致力于成为全球领先的高性能电子材料与存储科技公司。

在光伏材料领域，公司主要从事用于光伏电池金属化环节的导电浆料产品的研发、生产和销售。导电浆料是太阳能电池制造的关键原材料，作为金属化电极直接影响太阳能电池的光电转换效率与光伏组件的输出功率，是推动光伏电池技术革新与转换效率不断提升的主要推动力之一。随着光伏技术的发展，公司持续推出了全品类导电浆料产品组合以满足下游客户对于不同类型光伏电池的金属化需求，包括：P 型 BSF 电池导电银浆产品，P 型 PERC 电池副栅银浆产品及主栅银浆产品，N 型 TOPCon 电池全套导电银浆产品、N 型 TOPCon 电池低银含浆料产品、N 型 TOPCon 电池种子层浆料与高铜浆料产品，N 型 TBC 电池全套导电银浆产品，N 型 HJT 电池全套低温银浆及银包铜浆料产品，N 型 HTBC 电池全套低温银浆及银包铜浆料产品，钙钛矿/晶硅叠层电池超低温银浆及银包铜浆料产品等。报告期内，公司积极引领 TOPCon 电池高铜浆料金属化方案的量产实践，加快多类型电池纯铜浆料金属化方案的开发迭代等。公司的其他光伏材料还包括用于先进组件互联的叠瓦导电胶、0BB 结构胶，用于铜基金属化、HJT、钙钛矿等先进组件封装的高阻水丁基胶密封胶。

在电子材料领域，基于共性导电浆料技术平台，公司形成了系列用于半导体封装领域的高性能电子浆料产品：LED 芯片封装银浆，IC 芯片封装银浆，功率半导体芯片/模组封装烧结银与烧结铜，功率半导体 AMB 陶瓷覆铜板有银钎焊浆料与无银钎焊浆料等。同时，公司面向电子元器件领域也推出了多款电子浆料产品用于敏感电阻、电感、射频器件，以及新能源汽车调光玻璃等。报告期内，公司积极探索银包铜浆料技术、纯铜浆技术在半导体与电子领域的应用。

在存储芯片领域，公司通过收购江苏晶凯半导体技术有限公司实现了贯穿“应用性开发设计——晶圆测试——封测”一体化产业链，已量产 LPDDR3/4/4X、LPDDR5/5X、DDR4 等系列产品，广泛应用于 OTT 机顶盒、TV、手机、平板、IPC、AIOT 等消费电子与智能终端领域。

## （二）公司的经营模式

### 1、采购模式

公司的原材料采购模式主要为以产定购，同时考虑客户历史采购情况、生产周期等因素，备有一定库存。公司设置采购部，由其负责公司生产、研发所需原材料的采购。

公司生产所需的原材料主要包括银粉/银包铜粉/铜粉等金属粉、玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂等。其中，银粉是公司最主要的原材料，其定价方式主要为在银点价格基础上加收一定的加工费。公司结合销售订单、生产计划及备货情况下达采购订单，同时实行多供应商模式以提高供应安全性与降低采购成本。玻璃氧化物、有机树脂和有机溶剂方面，公司根据市场供需情况确定采购价格，并结合生产需求下达采购订单。

公司建立了采购过程控制程序，对供应商进行严格的筛选、评审，确保原材料质量和供货稳定性，以实现优质低价的采购目标。

### 2、生产模式

公司主要实行以销定产的生产模式并自行生产。公司根据客户销售订单情况，同时考虑历史采购数据、采购稳定性、产品性能需求等因素，对不同型号的产品需求量进行预估，结合公司产能情况制定生产计划，从而合理利用产能，实现产品的快速生产，保障客户的产品供应。

公司根据 ISO9001 质量管理体系、企业标准及客户需求控制产品质量，并制订进料检测、过程控制、成品检测及出厂检测程序，对产品粘度、固含量、细度、电性能、拉力等指标进行质量控制，确保产品符合企业标准及客户需求。

### 3、销售模式

公司采取直销为主，经销为辅的销售模式，具体如下：

（1）以直销为主，销售团队重点开拓和维护优质客户

公司销售团队根据下游市场动态并结合公司生产能力、技术水平及产品质量，有针对性的根据客户需求进行销售渠

道开拓，并由研发中心及时提供技术支持，满足客户对产品性能的需求。公司目前直销主要针对下游知名度高、信用度高、产品需求大的优质客户，并根据客户规模、区域情况进行划分后交由不同业务组及销售人员重点跟踪及维护，从而及时把握客户需求变化，建立稳定的合作关系。

(2) 以经销为辅，由经销商维护和开拓部分中小客户

随着业务规模的不断扩大，为提高销售效率，对于部分需求量较小的客户，或在公司销售网络覆盖相对薄弱的地区，公司将商务谈判或客户维护交由经销商进行，公司进行技术接洽和服务，并根据销售订单将产品发送至终端客户指定地点。

公司根据客户信誉、市场地位、订单规模及双方协商情况为客户提供一定的信用期，回款方式主要为银行承兑汇票，其余多为银行转账。

#### 4、研发模式

公司主要采取自主研发模式，设立了研发中心，下设研发部、研发管理部、应用技术部，并同销售部门相互配合，根据市场技术变化或客户产品需求情况，制定新产品开发计划和研发方案，组织人员进行策划和研发，并持续跟踪小试、中试和批量生产时客户的反馈情况，及时对产品方案进行调整，以确保产品研发与市场、客户需求相匹配。公司一直重视在技术研发上的持续投入，高度关注上下游技术变革，并依托高素质的研发团队，实现产品的技术更新，具备对下游需求良好的前瞻性、快速响应能力及产品开发能力。

依托上述研发模式，公司将研发方向与市场、客户需求紧密结合，成功建立了市场和客户需求分析—产品和技术开发—试样—批量生产—客户反馈的整套服务流程，以持续保持技术的领先性，提升市场占有率及品牌形象。

#### (三) 公司主要的业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 1,804,612.94 万元，较上年同期增长 17.56%；归属于上市公司股东的净利润-27,645.20 万元，较上年同期下降 176.80%。

2026 年，公司将继续坚持以技术创新为核心的经营理念，保持产品技术领先优势，紧密把握下游市场需求和产业动态变化，加强风险管理。在光伏材料领域，以导电浆料产品为核心，加快新技术、新产品、新应用的推出和领先产品的迭代升级，加强营销体系建设与推广力度，完善客户管理，不断提升核心产品市场占有率，并积极布局拓展先进组件互联封装材料；在电子材料领域，加强半导体封装浆料、电子元器件浆料产品的研发和推广，拓宽产品在功率半导体与车规级汽车电子领域的应用；在存储芯片领域，持续加大存储市场开发和产品研发力度，积极把握行业高景气机遇与 AI 历史机遇。此外，继续优化供应链管理，降低产品成本，实现降本增效。公司将持续增强企业管理能力，努力抓住市场机遇，改善经营业绩，提升公司持续经营能力。

公司业绩驱动因素主要有以下几点：

##### 1、技术创新和产品研发

公司高度重视研发团队建设，不断引进高端技术人才，培养了由国内外专家组成的研发团队。经过多年来在导电浆料领域的研发、完善，公司形成了以市场为导向、客户需求驱动的自主研发体系，掌握了以玻璃体系、有机体系、金属粉体系（包括银粉、银包铜粉、铜粉等）为代表的多项核心技术，能根据市场技术变化或客户产品需求开展同步、快速的研发，及时把握市场技术动态、满足客户需求，主营业务为客户提供高性能的光伏电池金属化浆料解决方案，具备前瞻性和快速反应能力。凭借先进的技术水平、突出的研发能力和良好的产品质量，公司获得了光伏产业知名厂商的广泛认可，品牌知名度不断提升。

在光伏材料领域，公司应用于 N 型 TOPCon 电池的全套导电浆料产品性能与市场份额处于行业领先地位。作为行业内最早推动 TOPCon 激光增强烧结金属化技术量产实践的厂商，在报告期内随着激光增强烧结金属化技术成为 TOPCon 电池量产标配工艺，公司持续改进导电浆料产品，巩固和强化了在 TOPCon 激光增强烧结专用导电浆料领域的领先地位，公司在行业内最早推出 TOPCon 电池种子层浆料与高铜浆料两次印刷的铜基少银金属化方案，并与龙头客户合作引

领了产业化量产实践。公司应用于 N 型 TBC 电池的导电浆料产品在龙头客户处持续大规模量产出货，产品性能处于行业领先地位。公司应用于 N 型 HJT 电池的低温银浆及银包铜浆料产品性能领先，持续大规模量产出货。公司应用于 HTBC 电池的低温浆料、钙钛矿/晶硅叠层电池的超低温浆料、先进组件互联的 0BB 结构胶、先进组件封装的高阻水丁基密封胶实现批量出货。

在电子材料领域，应用于 LED/IC 芯片封装的银浆产品持续迭代升级；针对功率半导体封装应用，芯片/模组封装用烧结银、AMB 陶瓷覆铜板钎焊浆料产品迭代与市场推广扎实推进；针对电子元器件应用，敏感电阻、电感、射频器件等应用的电子浆料产品开发与业务拓展稳步推进，特别是用于新能源汽车调光玻璃的电极银浆产业化取得重要突破，不断增强公司在半导体电子行业的品牌影响力。

在存储芯片领域，公司通过收购江苏晶凯半导体技术有限公司实现了贯穿“应用性开发设计——晶圆测试——封测”一体化产业链，已量产 LPDDR3/4/4X、LPDDR5/5X、DDR4 等系列产品，广泛应用于 OTT 机顶盒、TV、手机、平板、IPC、AIOT 等消费电子与智能终端领域。

## 2、优质服务和业务拓展

公司销售团队和研发中心相互配合，及时掌握行业技术革新情况及上下游对导电浆料等高性能电子材料的技术诉求，精准分析市场动态及客户需求，形成了具有公司特色的快速响应机制。公司技术研发优势及快速响应的服务机制不仅能够根据客户反馈及时改进产品，满足客户不同的技术指标需求，还有利于根据行业技术革新趋势前瞻性地与客户及产业链合作伙伴开展联合研发，为光伏行业提供了创新性的激光增强烧结金属化方案、高铜浆料金属化方案等，提升客户满意度的同时增强客户粘性。

公司不断提升对既有客户的销售服务品质，实现在既有客户中份额占比的提升。结合新一轮光伏产业周期下电池技术升级以及制造产能头部化集中的趋势，公司在光伏导电浆料业务拓展上加大了面向一线头部客户的销售资源分配和投入力度，进一步优化客户结构、提升出货规模。同时随着 N 型光伏电池技术与金属化技术的快速发展，公司也加大了面向新客户、新技术的业务与市场开发力度。在半导体封装浆料、电子元器件浆料等电子材料产品的市场拓展中，加大销售、市场与技术服务资源的投入，充分利用公司研发技术优势，赋能多应用领域业务拓展。在存储芯片领域，公司将继续加大存储市场开发和产品研发力度，把握高景气市场机遇与 AI 历史机遇。

报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

## （四）报告期内公司所处行业发展情况

### 1、公司所处行业发展现状和趋势

#### （1）全球光伏行业发展现状和趋势

光伏产业是全球能源结构转型的重要发展方向，世界各国均高度重视光伏产业的发展。据光伏行业协会数据，全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球发展的广泛共识，再加上光伏发电在越来越多的国家和地区成为最有竞争力的能源形式，预计未来随着光伏组件功率持续推升、光储平价加速，以及新兴市场拓展、老旧项目汰换、AI 算力中心能源建置等长期题材推进，全球光伏新增装机长期呈持续增长态势。2025 年 11 月 22 日第二十次 G20 峰会通过《二十国集团领导人约翰内斯堡峰会宣言》，宣布支持通过现有目标与政策，共同推动到 2030 年全球可再生能源装机容量增至 2022 年的三倍。整体而言，全球光伏市场仍有很大增长空间。

中国光伏新增装机规模已连续多年位居世界首位。根据国家能源局发布数据，2025 年国内光伏发电新增装机 315.07GW，同比增长超 13.3%，创历史新高。中国光伏行业协会预计，2026 年，预计国内新增装机量相较 2025 年有所回调。不过，2027 年起预计国内新增装机逐渐增加，到 2030 年预计达 270~320GW。报告期内，针对光伏行业内卷式竞争，国家层面主管部门和监管单位已提出明确指导意见，开展全方位专项“反内卷”治理工作，促使光伏行业重回健康、可持续性发展周期。展望未来，国内光伏行业将继续为推动全球能源清洁转型和世界经济低碳增长作出积极贡献。

总体来看，国内外“零碳”愿景和可再生能源政策目标不断提高，通过自上而下驱动光伏产业下游装机的增长，从

而提高了光伏行业远期发展空间的确信性和成长性。随着全球“双碳”进程的推进，光伏行业未来发展空间广阔。



2011-2025 年全球光伏年度新增装机规模以及 2026-2030 年新增规模预测 (单位: GW)

数据来源: 《2025-2026 年中国光伏产业发展路线图》

## (2) 存储行业发展现状和趋势

2024 年以来，全球半导体行业呈现持续增长态势，AI 驱动的高性能计算需求成为核心增长引擎，AI 的发展不仅重塑了半导体行业需求结构，也带动了芯片制造和封装测试的技术升级和迭代。在数字经济各领域对存储技术需求不断扩大的推动下，存储市场规模持续上升。

数据中心与 AI 服务器是当前存储市场中技术最前沿、增长最快的领域；为满足深度学习等数据密集型任务对带宽和延迟的极致要求，市场对高带宽内存 (HBM)、高速 DDR5 以及高性能固态硬盘 (SSD) 的需求呈现爆发式增长，直接拉动了存储产业向更高性能层级演进。生成式 AI 向端侧集成，推动智能手机与 PC 的存储配置全面升级；AI 手机大模型运行需海量数据实时处理，对内存和闪存的容量、性能提出了更高要求，成为硬件升级的关键；AI PC 凭借其大屏幕、强交互与大容量存储优势，AI PC 有望成为个人生产力工具，本地运行 AI 模型同样驱动着大容量内存和存储的需求。再者，汽车智能化驱动车载存储迈入新阶段；在汽车电动化与智能化浪潮下，数据量激增，从智能座舱到自动驾驶，各个系统单元均需要存储芯片支持，推动车载存储向更大容量、更高速度、更强稳定性的方向快速发展。

在价格方面，2025 年存储全系产品价格已出现较大涨幅，2026 年或进一步上涨，本轮价格上涨是由 AI 服务器和通用服务器共同驱动，同时存在着结构性的产能转换和多个维度的需求竞争，情况复杂，短缺和涨价或将会持续更长时间。

受益于人工智能、云基础设施等领域持续旺盛的需求，存储市场需求激增。根据世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 2025 年 12 月发布的秋季展望报告，2025 年全球半导体存储市场 (存储器) 销售额同比增长 28%，成为推动整体半导体市场增长的核心动力之一，并预计将在 2026 年增长 30% 以上。

## 2、光伏导电浆料的市场展望

导电浆料作为光伏电池制造的关键原材料，直接影响光伏电池的光电转换效率与光伏组件的输出功率，是推动光伏电池技术革新与发展的主要推动力之一。通过印刷导电浆料实现光伏电池金属化是最具性价比的方式，具有长期不可替代性。凭借光伏导电浆料技术创新，光伏电池制造环节可以通过高方阻、细线印刷与多主栅等工艺提升电池转换效率、优化浆料用量，但全球光伏装机量的持续增长与光伏新技术的快速应用都将推动光伏导电浆料市场的健康发展。一方面，全球光伏新增装机需求的中长期韧性仍在。中国光伏行业协会预测，“十五五”期间，全球年均光伏新增装机量将达 725~870GW。AI 算力中心、太空光伏等新兴场景持续拓宽背景下的需求也将形成对导电浆料市场持续发展的有力支

撑。另一方面，光伏电池技术进步使得单瓦浆料用量有所上升，同时浆料加工费溢价有望提升。2022 年以来，光伏电池技术快速从 P 型 PERC 电池往 N 型 TOPCon 电池技术升级，TOPCon 现在已经成为新的主流光伏电池技术。后续，TBC/HJT/HTBC 等电池技术创新与产业化发展，以及银包铜浆料、铜浆等低银/无银金属化技术创新与产业化发展，都有望提振相应配套浆料产品的盈利水平。

### 3、公司主要产品的行业地位

报告期内，公司主要产品是太阳能电池导电浆料，为客户提供太阳能电池金属化解决方案。在光伏产业链中，光伏导电浆料产品主要用于光伏电池的金属化环节，是光伏电池乃至整个光伏产品的关键材料。只有通过导电浆料形成的金属化电极，光伏电池的光生电流才能被导出作为光伏电力使用。光伏导电浆料的性能直接决定了光伏电池的光电转换效率与光伏组件的输出功率，是光伏产业链通过技术创新实现提效降本的关键核心材料。同时，光伏导电浆料作为光伏产品的构成要素之一，其品质的好坏也对光伏组件产品的质量与长期寿命有一定的影响。

公司依托国际化研发团队，通过多年来的技术研发和持续创新，逐步形成了以市场为导向、以客户需求驱动的自主研发体系，掌握了以玻璃体系、有机体系、金属粉体系（包括银粉、银包铜粉、铜粉等）为代表的多项核心技术，形成了多系列光伏导电浆料产品，获得了包括晶科能源、隆基绿能、晶澳太阳能、通威太阳能、阿特斯、协鑫集成、横店东磁、中润光能、英发睿能、捷泰科技、爱旭股份、Hanwha Qcells、Waaree 等光伏产业知名厂商的广泛认可并建立了长期稳定的合作关系，树立了“高效、稳定、可靠”的良好品牌形象，是全球领先的光伏导电浆料供应商，在行业中享有较高的知名度和美誉度。

未来公司将充分利用技术研发优势和品牌优势，继续加大研发投入和市场推广力度，加快产品的迭代升级。在光伏材料领域，持续夯实 N 型 TOPCon 电池全套导电浆料的性能和市场领先地位，持续强化 N 型 TBC 电池全套导电浆料方案的产品优化与领先性，持续发力 HJT 电池全套低温银浆及银包铜浆料的迭代升级与技术创新，持续引领超细线技术、掺镍等低银含浆料技术、高铜浆料技术、铜浆技术等少银/无银金属化技术的开发与量产应用，积极开展投入 HTBC、钙钛矿/晶硅叠层电池导电浆料开发与先进组件互联封装材料方案开发，积极布局太空光伏用超高可靠性金属化与互联材料，继续巩固和提升公司的市场份额，与全球光伏产业共同成长。在电子材料领域，公司将加强半导体封装浆料、电子元器件浆料产品的研发和市场推广，不断拓宽公司产品的应用领域和市场。在存储芯片领域，公司快速扩大相关 LPDDR、DDR 产品在消费电子、智能终端领域应用的同时，积极布局在端侧 AI 与 AI 算力领域的新产品开发。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	11,199,303,176.59	7,831,823,389.39	43.00%	6,784,718,315.13
归属于上市公司股东的净资产	1,575,899,203.88	1,673,844,500.20	-5.85%	1,323,362,421.61
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	18,046,129,376.57	15,350,571,546.73	17.56%	9,602,822,670.15
归属于上市公司股东的净利润	-276,452,030.19	359,961,693.46	-176.80%	385,640,607.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	163,441,009.96	439,103,856.09	-62.78%	342,963,420.06

的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	667,581,670.28	938,702,930.65	-28.88%	-1,050,991,565.28
基本每股收益（元/股）	-1.92	2.56	-175.00%	2.75
稀释每股收益（元/股）	-1.92	2.50	-176.80%	2.74
加权平均净资产收益率	-16.93%	24.56%	-41.49%	34.46%

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,056,022,922.37	4,283,919,159.88	4,383,707,184.57	5,322,480,109.75
归属于上市公司股东的净利润	34,627,885.56	35,179,436.20	-40,350,728.77	-305,908,623.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,626,615.91	23,862,170.51	38,126,495.10	36,825,728.44
经营活动产生的现金流量净额	307,345,948.90	-637,800,074.42	379,660,573.82	618,375,221.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,251	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
史卫利	境内自然人	14.29%	20,765,737.00	15,574,303.00	质押	5,028,000.00			
无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.74%	6,886,880.00	0.00	不适用	0.00			
上海乾赢投资管理有限公司—乾赢价值成长 7 号	其他	3.87%	5,616,800.00	0.00	不适用	0.00			

私募证券投资基金						
华能贵诚信托有限公司—华能信托·博远宜诚集合资金信托计划	其他	1.69%	2,457,000.00	0.00	不适用	0.00
钱亚萍	境内自然人	1.48%	2,143,925.00	0.00	不适用	0.00
锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）—锦福源五号私募证券投资基金	其他	1.44%	2,091,000.00	0.00	不适用	0.00
秦皇岛宏兴钢铁集团有限公司	境内非国有法人	1.35%	1,957,002.00	0.00	不适用	0.00
锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）—锦福源天添二号私募证券投资基金	其他	1.27%	1,840,409.00	0.00	不适用	0.00
新疆 TCL 股权投资有限公司	境内非国有法人	1.16%	1,690,120.00	0.00	不适用	0.00
闫经梅	境内自然人	1.12%	1,620,847.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、史卫利控股的无锡而为科技有限公司是无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人； 2、闫经梅系史卫利母亲； 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

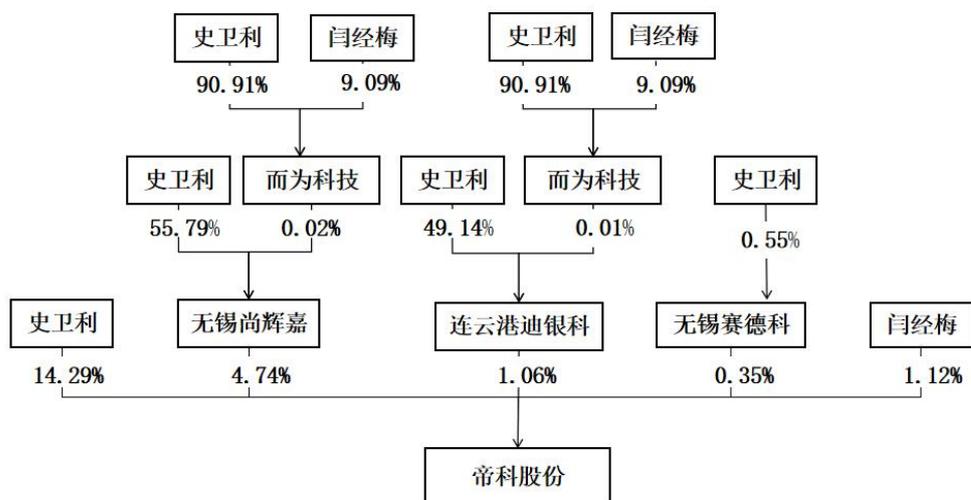
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

## 三、重要事项

## 1、关于公司 2024 年年度权益分派实施情况

公司于 2025 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第九次会议以及 2025 年 3 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司本次利润分配方案为：以公司现有股本 140,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 42,210,000.00 元（含税），本次利润分配不转增股本，不送红股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2025-018）。上述权益分派方案已于 2025 年 4 月 9 日分派完成。

## 2、关于公司限制性股票激励计划归属事项

2025 年 5 月 6 日，公司于巨潮资讯网披露《关于 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-030）以及《关于 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2025-029），公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第三个归属期归属股票及 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属股票于 2025 年 5 月 9 日上市流通，公司总股本从 140,700,000 股增加至 141,762,418 股。公司于 2025 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第四个归属期归属条件成就的议案》及《关于公司 2024 年限制性股票激励计划限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司已按照相关规定为符合归属条件的激励对象办理限制性股票归属相关事宜并于 2025 年 11 月 6 日上市流通。公司总股本由 141,762,418 股增加至 145,279,743 股。

## 3、关于公司现金收购浙江索特材料科技有限公司 60% 股权暨关联交易事项

公司于 2025 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币 69,600.00 万元收购浙江索特材料科技有限公司 60% 股权。本次交易完成后，浙江索特将成为公司的控股子公司，公司将通过浙江索特控制原杜邦集团旗下 Solamet® 光伏银浆业务。基于保护上市公司和中小投资者的利益考虑，公司控股股东、实际控制人之一史卫利先生自愿

对浙江索特做出业绩补偿承诺，公司与史卫利先生签署《无锡帝科电子材料股份有限公司与史卫利之业绩承诺及补偿协议》，上述承诺导致本次交易构成关联交易。2025 年 7 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于签署现金收购股权相关补充协议暨关联交易的议案》及《关于批准本次交易加期审计报告的议案》。为充分保护上市公司和中小投资者的利益，经友好协商，2025 年 7 月 25 日，上市公司与史卫利先生签署《无锡帝科电子材料股份有限公司与史卫利之业绩承诺及补偿协议之补充协议》，对业绩承诺补偿计算周期、支付时长和资产减值补偿等事项进行了重新约定。2025 年 8 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购浙江索特材料科技有限公司 60%股权暨关联交易的议案》。